

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ОДНООСНО-НАПРЯЖЕННОМ $Cd_xHg_{1-x}Te$

С. Г. Гасан-заде, Г. А. Шепельский

Институт полупроводников Академии наук Украины, 252650, Киев, Украина
(Получена 22 декабря 1992 г. Принята к печати 15 марта 1993 г.)

В узкощелевом полупроводнике $Cd_xHg_{1-x}Te$ ($x \approx 0.20-0.30$) исследовались рекомбинационные механизмы и кинетические явления при трансформации зонной структуры одноосной упругой деформацией. Показано, что наряду с резкими изменениями коэффициента Холла, удельного сопротивления, полевых зависимостей магнитосопротивления и фотомагнитного эффекта, связанными с расщеплением валентной зоны и уменьшением эффективной массы дырок в упругонапряженном кристалле, происходит и изменение темпа межзонной и примесной рекомбинации. В частности, темп межзонной излучательной рекомбинации растет, а ударной рекомбинации — падает с ростом деформации. В случае примесной рекомбинации с участием мелких акцепторов наблюдается увеличение темпа рекомбинации из-за ослабления процессов захвата неосновных носителей заряда на акцепторное состояние.

В узкощелевом полупроводнике (УП) $Cd_xHg_{1-x}Te$ с составом $x \approx 0.20-0.30$ — в актуальном материале ИК фотоэлектроники, рекомбинационные процессы определяются несколькими конкурирующими механизмами. Вклад конкретного механизма рекомбинации в результатирующее время релаксации неравновесной концентрации носителей тока зависит от температуры, плотности точечных дефектов и примесей. Из-за особенностей зонной структуры УП (малой ширины запрещенной зоны ϵ_g и малого отношения эффективных масс электронов зоны проводимости и тяжелых дырок $\mu = \frac{m_e}{m_h} \ll 1$) по крайней мере в температурном диапазоне, соответствующем собственной проводимости, время релаксации определяется межзонными переходами — излучательной и ударной рекомбинацией [$^{1-3}$].

Темп межзонной рекомбинации естественно не зависит от примесных уровней и характеризуется параметрами собственного зонного спектра полупроводника. Поэтому межзонная рекомбинация является принципиально неустранимой и задает верхний теоретический предел времени жизни носителей тока. Исходя из этого, представляется интерес задача, заключающаяся в контролируемой трансформации энергетического спектра с помощью каких-либо внешних воздействий с тем, чтобы изменять важные с практической точки зрения параметры неравновесных носителей тока. Одним из таких воздействий может быть одноосное упругое напряжение. В полупроводниках с кубической кристаллической структурой одноосная деформация, понижая симметрию кристаллической решетки, снимает вырождение валентной зоны в точке Γ_8 (при $k=0$) и приводит к изменению эффективных масс дырок в расщепленных подзонах [4]. В полупроводниках типа Ge и Si из-за относительно небольшого по величине отношения масс тяжелой и легкой дырки m_h/m_i , воздействие деформации на параметры валентной зоны и примесных центров оказывается незначительным. Для $Cd_xHg_{1-x}Te$ отношение $m_h/m_i \gg 1$ (при $x=0.20 m_h/m_i \approx 50$), поэтому наложение

одноосной деформации может приводить к существенным изменениям структуры валентной зоны и примесных состояний. Результаты подобных исследований кинетических явлений в одноосных-деформированных p -InSb и p -Cd_xHg_{1-x}Te изложены в [5, 6].

В настоящей работе основное внимание уделено изменению рекомбинационных параметров в упругонапряженном Cd_xHg_{1-x}Te n -типа. Кроме этого, для установления трансформации валентной зоны проводились измерения кинетических параметров в p -Cd_xHg_{1-x}Te.

Исследовались образцы Cd_xHg_{1-x}Te двух составов $x \approx 0.20$ и $x \approx 0.30$ с концентрацией активных примесей $N_D - N_A = 1.5 \cdot 10^{14} - 5 \cdot 10^{15}$ см⁻³ и $N_A - N_D = 3 \cdot 10^{15} - 2 \cdot 10^{16}$ см⁻³. Параметры образцов приведены в таблице. Измерения

Параметры исследованных образцов Cd _x Hg _{1-x} Te, T = 78 K				
№ образца	Тип проводимости	Состав x	$n(p)$, см ⁻³	$\mu_n(\rho)$, см ² /В · с
1	p	0.205	$1.68 \cdot 10^{16}$	$3.81 \cdot 10^2$
2	p	0.200	$1.21 \cdot 10^{16}$	$7.92 \cdot 10^2$
3	n	0.190	$1.26 \cdot 10^{15}$	$2.89 \cdot 10^5$
4	n	0.200	$5.65 \cdot 10^{14}$	$1.37 \cdot 10^5$
5	n	0.295	$1.53 \cdot 10^{14}$	$2.92 \cdot 10^4$

проводились непосредственно после химического травления образцов в 5% растворе брома в метаноле с последующей промывкой в изобутиловом спирте. Измерения проводились в диапазоне температур 1.7—280 К, магнитных полей 0—70 кЭ и упругих деформаций 0—3 кбар. В качестве источника излучения использовались глобар в области длин волн $\lambda = 0.5—14$ мкм и лазер ЛГ-126 ($\lambda = 3.39$ мкм).

Результаты эксперимента и их обсуждение

За изменением структуры валентной зоны и основных параметров носителей тока при упругой деформации можно проследить измеряя коэффициент Холла R_x и удельное электрическое сопротивление ρ в кристалле Cd_xHg_{1-x}Te с дырочной проводимостью. На рис. 1 представлены деформационные зависимости R_x и ρ в p -Cd_xHg_{1-x}Te ($x \approx 0.20$) при двух значениях температуры. Одно из них ($T = 78$ K) соответствует полному истощению акцепторного уровня с энергией ионизации ϵ_A , ответственного за концентрацию свободных дырок в валентной зоне. При другой температуре ($T = 1.7$ K) практически все дырки оказываются вымороженными из валентной зоны на акцепторный уровень.

При температуре опустошения акцепторов R_x практически не зависит от деформации (рис. 1), так что все изменения проводимости определяются лишь ростом подвижности дырок, связанным с уменьшением эффективной массы у потолка валентной зоны. При этом, как и в p -InSb [7], наблюдается анизотропия проводимости, измеряемой в продольном и поперечном направлениях по отношению к направлению деформации. Параметр анизотропии для направления деформации [110] при значениях давления $P = 2.5$ кбар достигает значения $\mu_{\parallel}/\mu_{\perp} \approx 2.13$.

При понижении температуры ($T < 40—50$ K) в p -Cd_xHg_{1-x}Te происходит переход дырок на состояние акцепторного уровня, так что при $T = 1.7$ K практически все дырки оказываются связанными, а проводимость определяется токопереносом по состояниям примесной акцепторной зоны, либо состояниями поверхности и включений n -типа. При таких температурах наблюдается характерный изгиб в температурной зависимости ρ (рис. 1, вставка), а коэффициент Холла может менять знак на отрицательный. При вымораживании дырок на-

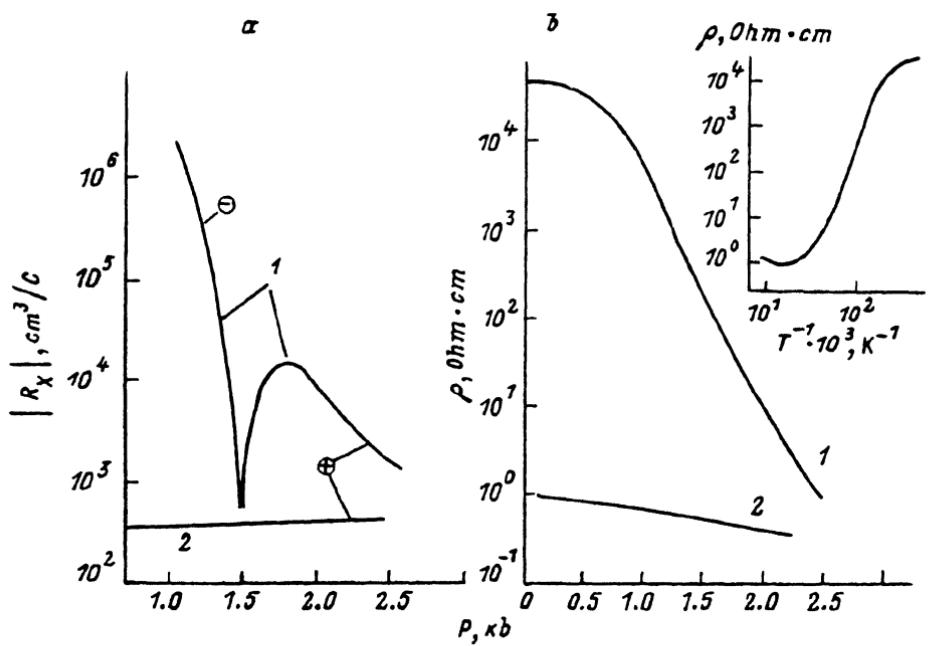


Рис. 1. Деформационные зависимости коэффициента Холла (а) и удельного электрического сопротивления (б) при $T = 1.7$ К (кривые 1) и 78 К (кривые 2) для образца I. R_x измерялось при $H = 5$ кЭ. На вставке — температурная зависимость ρ .

блудается экспоненциальная зависимость R_x и ρ от температуры, позволяющие определить глубину залегания акцептора. В зависимости от концентрации акцепторов в исследуемых образцах эта величина находится в пределах $\epsilon_A = 4 - 7$ мэВ. Как видно из рис. 1, наложение одноосной деформации при низкой температуре ($T = 1.7$ К) вызывает изменение ρ и R_x на несколько порядков, что сразу указывает на концентрационную природу эффекта. При этом у образцов $p = \text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ с отрицательным R_x при $T = 1.7$ К происходит инверсия знака R_x с ростом деформации P . Валентная зона в точке $k = 0$ расщепляется в результате деформации на две подзоны, при этом эффективная масса верхней из подзон оказывается много меньше m_b — эффективной массы тяжелых дырок в отсутствии деформации. При достаточно большом напряжении, когда расщепление подзон, линейно зависящее от P , превышает энергию ионизации акцептора [$\epsilon_0(P) > \epsilon_A$], состояние последнего формируется в основном состояниями верхней из расщепившихся подзон. Как показано в [5], зависимость энергии основного состояния акцептора от одноосной деформации хорошо согласуется с моделью мелкого примесного центра. В результате с ростом P наблюдается уменьшение ϵ_A и происходит заброс дырок в состояния валентной зоны, что и объясняет резкое изменение R_x и ρ . Из температурных зависимостей ρ , измеренных при разных значениях сжатия (рис. 2) видно, что энергия ионизации ϵ_A уменьшается вплоть до перехода проводимости к практическому безактивационному режиму. При этом подвижность дырок в верхней из расщепившихся подзон, определяемая как произведение $R_x\sigma$ при достаточно высокой температуре ($T > 10$ К), когда можно пренебречь вкладом проводимости по примесям, с ростом деформации растет и выходит на насыщение, достигая значения $\mu_p < 4 \cdot 10^4$ см²/В·с.

Уменьшение энергии ϵ_A и переход дырок в свободные состояния в деформированном $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ приводит к изменениям магнитополевых зависимо-

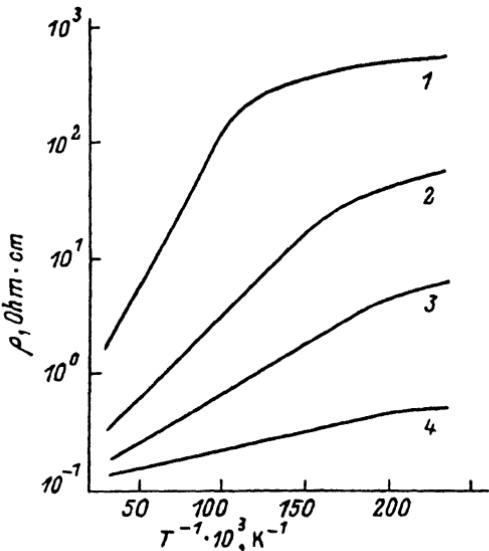


Рис. 2. Температурные зависимости ρ для образца 2 при разных значениях деформаций P , кбар: 1 — 0, 2 — 1.5, 3 — 2.1, 4 — 2.9.

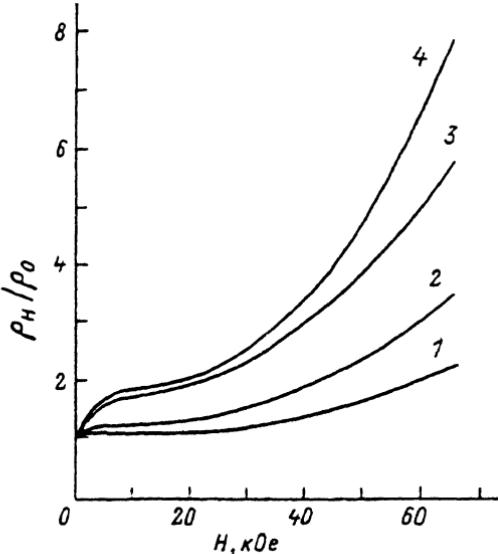


Рис. 3. Магнитосопротивление образца 2 при разных значениях деформации P , кбар: 1 — 0, 2 — 1.5, 3 — 2.1, 4 — 2.9. $T = 4.2$ К.

стей электрического сопротивления ρ_H и фотомагнитного эффекта (ФМЭ). В отсутствие деформации из-за небольшой подвижности тяжелых дырок магнитосопротивление в $p\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ относительно невелико. При достаточно большой деформации полевая зависимость ρ_H становится значительно более сильной (рис. 3). Сопоставление полевых зависимостей продольного и поперечного магнитосопротивлений, а также R_X при разных значениях температуры показывает, что начальный участок ρ_H деформированного $p\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ определяется подвижность, которая значительно возросла с деформацией. Дальнейший рост ρ_H имеет концентрационную природу и связан с магнитным вымораживанием свободных дырок на акцептор, энергия ионизации которого возрастает в сильном магнитном поле [6].

Изменение эффективной массы и подвижности дырок с деформацией может проявляться и в кристаллах n -типа, например, по полевым зависимостям биполярного ФМЭ (рис. 4). Действительно, ФМЭ определяется параметрами неосновных носителей тока. Поэтому в кристаллах n -типа в отсутствие деформации ФМЭ имеет линейную полевую зависимость, поскольку достигаемое магнитное поле является слабым ($\frac{\mu_p H}{c} < 1$). При увеличении деформации происходит изменение наклона полевой зависимости ФМЭ благодаря приближению к условию $\frac{\mu_p H}{c} > 1$ из-за роста μ_p .

Описанное выше расщепление валентной зоны и изменение эффективных масс дырок должны приводить и к заметным изменениям темпа рекомбинации при межзонных переходах. О первых таких исследованиях сообщалось в [8]. Теоретический расчет темпа излучательной ($1/\tau_R$) и оже-рекомбинации ($1/\tau_A$) проведен для кейновской модели с учетом одноосновной упругой деформации. При этом законы дисперсии и волновые функции записывались согласно Биру и Пикусу [4], а интегралы перекрытия и оптические матричные элементы соответствовали расчетам Гельмонта для трехзонной модели Кейна [9]. В де-

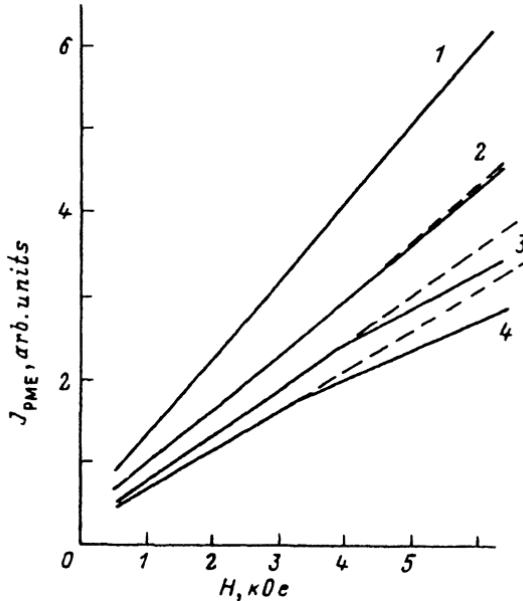


Рис. 4. Зависимости ФМЭ от магнитного поля для образца 3 при разных значениях деформации Р, кбар: 1 — 0, 2 — 1.5, 3 — 2.0, 4 — 2.5. $T = 20$ К.

формированном кристалле (расчет проведен для $Cd_xHg_{1-x}Te$) расщепленные валентные подзоны (рис. 5) удобно описывать смешанными состояниями тяжелых и легких дырок (V_+ - и V_- -зоны). Эффективные массы равны $m_0/\gamma_1 \pm 2\gamma$ — для продольного и $m_0/\gamma_1 \mp \gamma$ для поперечного направления (m_0 — масса свободного электрона, а γ_1 и γ — параметры Латтингера). По мере увеличения расщепления подзон $\epsilon_0(P)$ большая часть дырок собирается в зоне V_+ , а поскольку эффективная масса V_+ -зоны заметно уменьшается по сравнению с массой тяжелой дырки; то дырки локализуются в области малых импульсов (по сравнению с недеформированным кристаллом). В результате темп излучательной рекомбинации должен возрастать.

Для межзонной ударной рекомбинации (рекомбинации Оже) возникает обратная ситуация. Действительно, высокий темп оже-рекомбинации в УП с прямой запрещенной зоной обеспечивается малым отношением эффективных масс электронов и тяжелых дырок $\mu = m_e/m_b$, которое явно входит в выражение для времени релаксации:

$$\tau_{A1} \sim \left(\frac{\epsilon_g(T)}{kT} \right)^{3/2} \exp \left(\frac{\epsilon_g}{kT} \right) \exp \left(\frac{\mu}{1 + \mu} \frac{\epsilon_g}{kT} \right).$$

Здесь первый множитель описывает плотность состояний в зоне, второй — концентрацию собственных носителей тока и вызывает экспоненциальную зависимость τ_{A1} в области собственной проводимости. Третий же множитель обеспечивает выполнение закона сохранения импульса и энергии при рекомбинационном переходе, поскольку при межзональной ударной рекомбинации вертикальные переходы в k -пространстве запрещены. Из приведенных соотношений видно, что при малых значениях μ (в $Cd_xHg_{1-x}Te$ с $x = 0.20 \mu \approx 10^{-2}$) обеспечивается низкий порог перехода электронов в состояния тяжелых дырок. Темп рекомбинации в области собственной проводимости может быть записан, согласно [9], в виде

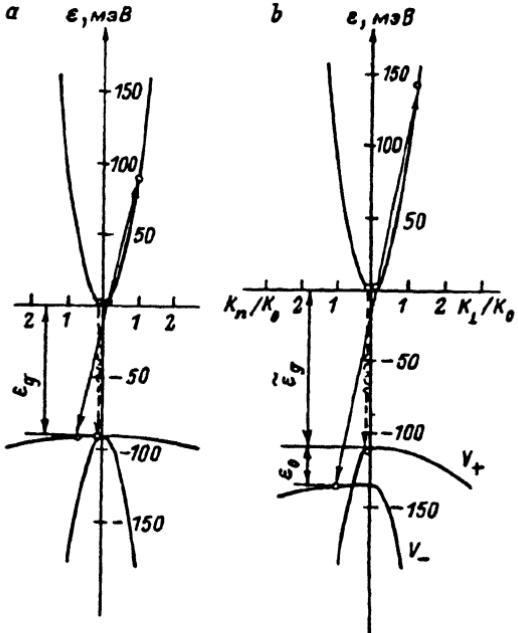


Рис. 5. Энергетическая структура и рекомбинационные переходы в Cd_{0.2}Hg_{0.8} Te при P , кбар: $a - 0$, $b - 2$; Р II [001]. Стрелками показаны: штриховые линии — излучательные переходы, сплошные — безизлучательные. Характерный волновой вектор $k_0 \approx 4 \cdot 10^6$ см⁻¹.

$$\tau_{A\downarrow}^{-1} = c(T) n^2 \exp(-\epsilon_t/kT),$$

где $c(T)$ — слабая степенная функция температуры, а ϵ_t — пороговая энергия процесса, которая для трехзонной модели Кейна имеет вид

$$\epsilon_t = 2 \frac{m_e}{m_h} \epsilon_g.$$

При наложении одноосной деформации и расщеплении валентной зоны эффективная масса электронов остается практически неизменной, в то время как масса дырок существенно уменьшается для всех состояний кроме V_- для продольного направления (рис. 5). В результате пороги для всех переходов электронов в дырочные состояния, кроме перехода в состояния V_- , резко повышаются и оже-переходы будут происходить преимущественно в состояния V_- -зоны с низким энергетическим порогом (последний, однако, превышает порог ϵ_t для недеформированного кристалла на величину расщепления зон V_+ и V_- : $\epsilon_t^- = \epsilon_t + \epsilon_0$). Деформационная зависимость τ_A будет теперь определяться порогом ϵ_t^- , а также концентрацией дырок, которая в V_- -зоне с ростом деформации экспоненциально убывает с постоянной ϵ_0/T . Эти два фактора должны приводить к существенному уменьшению темпа оже-рекомбинации [8, 10].

Основываясь на противоположной зависимости τ_R^{-1} и τ_A^{-1} от P , можно считать деформационные измерения простым и удобным методом разделения двух основных механизмов межзонной рекомбинации — излучательного и ударного. Как известно, само по себе такое разделение является непростой задачей и требует, например, подробных температурных исследований времени жизни носителей тока. До сих пор нет единой точки зрения на вклад излучательного

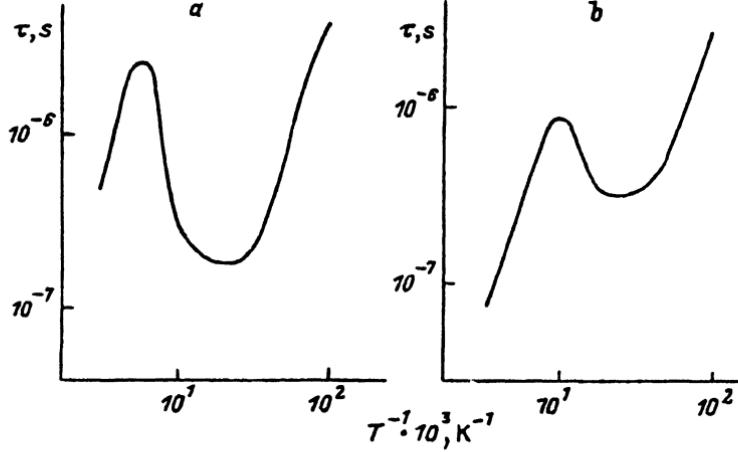


Рис. 6. Температурные зависимости τ для образцов $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$: а — 5, б — 3.

и ударного механизмов в рекомбинацию $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ при низких ($T < 100$ К) температурах. Однако и деформационные измерения не могут быть универсальным методом, как только в рекомбинации заметную роль начинает играть какой-либо третий канал — обычно связанный с уровнями примесей и дефектов. Это сразу осложняет задачу, особенно с учетом того, что в настоящее время, насколько нам известно, отсутствуют какие-либо теоретические расчеты деформационных зависимостей рекомбинационных переходов через примесные состояния.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для экспериментальных исследований целесообразен выбор таких температурных диапазонов и составов $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$, которым соответствует какой-либо один доминирующий механизм рекомбинации. Для кристаллов $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ n -типа высокой чистоты с большой подвижностью электронов ($\mu_b > 10^5 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$) во всем температурном диапазоне собственной проводимости основным оказывается излучательный канал для $x=0.30$ и ударный — для $x=0.20$ [¹⁻³]. Об этом свидетельствует и температурная зависимость времени релаксации у исследованных нами образцов (рис. 6). Следовательно, в температурном диапазоне $T > 150$ К для $x=0.30$ и $T > 110$ К для $x=0.20$ удается практически исключить из рассмотрения вклад примесной рекомбинации. В хорошо очищенных кристаллах $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ этот диапазон в действительности распространяется к значительно более низким температурам ($T=70-80$ К) и охватывает, таким образом, область наибольшего практического применения $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ в качестве материала для фотоприемников [¹].

На рис. 7 показаны деформационные зависимости времени релаксации τ (P) от τ_0 для различных значений состава и температуры. Видно, что если для более широкозонного состава ($x=0.30$) наблюдается уменьшение τ , то для $x=0.20$ — заметный рост с увеличением упругого напряжения. Максимальное отношение ε_0/kT , которое удается получить в эксперименте для $x=0.20$ при 120 К, по оценкам достигает значения 2.5 (для направления [100] $\varepsilon_0 = 8P = 8\{(1/4)b\} \times (s_{11} - s_{12})$ }, где b — константа деформационного потенциала, а s_{ij} — компоненты тензора упругой деформации). Этому отношению соответствует приблизительно двукратное увеличение τ_A , что неплохо согласуется с теоретическими расчетами для $x=0.20$ [¹⁰]. Важно, что сам характер изменения τ с деформацией однозначно определяет механизм собственной рекомбинации.

При низких температурах в кристаллах $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ время релаксации может определяться рекомбинационными переходами через примесный уровень,

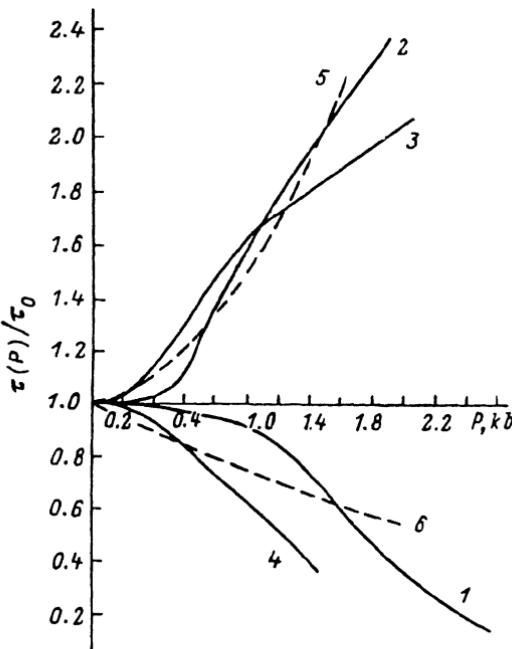


Рис. 7. Деформационные зависимости τ для образцов $Cd_xHg_{1-x}Te$: 1 — 4, 2 — 3, 3 — 3, 4 — 5. T , К: 1 — 4.2, 2 — 78, 3 — 130, 4 — 170. Штриховые линии — данные расчета: 5 — оже-рекомбинация, 6 — излучательная.

при этом существенную роль в наиболее низкотемпературном диапазоне начинают играть процессы прилипания неосновных носителей заряда на мелкий акцепторный уровень ($\varepsilon_A = 4\text{--}6$ мэВ) [3]. На это указывает увеличение τ в области низких температур (рис. 6). В этом случае упругая деформация также может заметно изменять темп рекомбинации, поскольку при этом трансформируется боровская энергия и сечение захвата акцептора в модели мелкого водородоподобного центра, характеризуемого состояниями ближайшей валентной зоны. Действительно, при больших деформациях ($\varepsilon_0 > \varepsilon_A$) энергия ионизации ε_A практически приближается к нулю. Как видно из рис. 7 (кривая 1), одноосная деформация в этом случае приводит к уменьшению τ , что можно связать с понижением глубины залегания акцептора и быстрой обратной тепловой ионизацией захваченных на акцептор дырок.

Таким образом, наряду с изменением кинетических коэффициентов УП $Cd_xHg_{1-x}Te$, связанным с трансформацией энергетического спектра валентной зоны и примесных центров, происходит и изменение рекомбинационных механизмов носителей тока. При этом в случае межзонных переходов одноосная деформация позволяет однозначно идентифицировать собственный механизм рекомбинации, поскольку темп излучательной рекомбинации растет, а темп оже-рекомбинации падает с ростом деформации. Последнее дает возможность по крайней мере в несколько раз повысить предельное теоретическое время жизни носителей заряда недеформированного кристалла, определяемое темпом оже-рекомбинации. Наконец, в случае рекомбинационных переходов через примесные состояния с участием мелких акцепторных уровней одноосное напряжение также заметным образом изменяет темп рекомбинации и может, таким образом, способствовать определению типа рекомбинационного центра. Практический аспект деформационных исследований УП заключается в том, что фотоприемники на основе монокристаллов или эпитаксиальных слоев $Cd_xHg_{1-x}Te$

в основном работают в охлажденном режиме и, как правило, находятся в упругонапряженном состоянии.

В заключение авторы выражают благодарность Ф. Т. Васько за полезные обсуждения результатов и Э. А. Зинченко за помочь в эксперименте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] M. A. Kinch, M. I. Brau, A. Simmons. *J. Appl. Phys.*, **44**, 1649 (1973).
- [2] G. Nimtz. *Phys. Reports (Review Section of Physics Letters)*, **63**, 265 (1980).
- [3] Н. Л. Баженов, Б. Л. Гельмонт, В. И. Иванов-Омский, А. А. Малькова, В. К. Огородников, Т. У. Тотиева. *ФТП*, **16**, 109 (1982).
- [4] Г. Л. Бир, Г. Е. Пикус. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М. (1972).
- [5] А. В. Германенко, Г. М. Миньков, О. Э. Рут. *ФТП*, **21**, 2006 (1987).
- [6] А. В. Германенко, Г. М. Миньков, Е. Л. Румянцев, О. Э. Рут, О. В. Инишева. *ФТП*, **23**, 796 (1989).
- [7] Е. Г. Валешко, О. Г. Кошелев, Т. Б. Плескачева. *ФТП*, **8**, 2205 (1974).
- [8] Ф. Т. Васько, С. Г. Гасан-заде, М. В. Стриха, Г. А. Шепельский. *Письма ЖЭТФ*, **50**, 287 (1989).
- [9] Б. Л. Гельмонт. *ЖЭТФ*, **75**, 536 (1978).
- [10] Ф. Т. Васько, М. В. Стриха. *УФЖ*, **35**, 1240 (1990).

Редактор Т. А. Полянская
